









### 绝对最大额定值

参数 (Parameter)	符号 (Symbol)	值 (Value)	单位 (Unit)
功耗 (Power Dissipation)			
正向电流 (Forward Current)			
峰值正向电流 (Peak Forward Current)			
反向电压 (Reverse Voltage)			
静电 (ESD)			
操作温度 (Operating Temperature)			°C
保存温度 (Storage Temperature)			°C
热阻 (Thermal Resistance)			°C/W
结温 (Junction Temperature)			°C

备注 (Remarks)

- 
- 脉宽0.1ms, 周期1/10







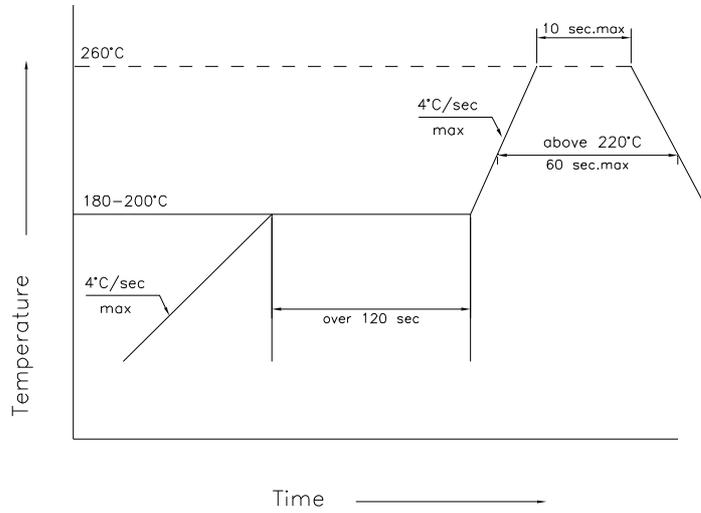






项目	参考标准	测试条件	时间	数量	接收/拒收
回流焊		250°C 10min 250°C 10min	10min	1000	0
温度循环		25°C 10min 25°C 10min -40°C 10min 125°C 10min -40°C 10min 125°C 10min	10min	1000	0
高温保存		125°C 10min	10min	1000	0
低温保存		-40°C 10min	10min	1000	0
常温通电		25°C 10min 100% RH	10min	1000	0
高温高湿通电					

### 回流焊说明



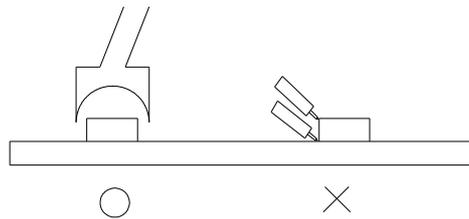
回流焊不可以做两次以上

当焊接时，不要在材料受热时用力压胶体表面

### 烙铁焊接

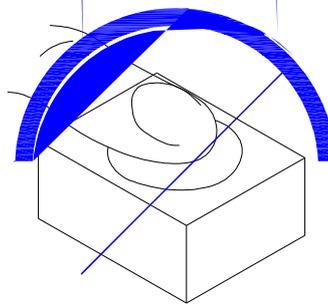
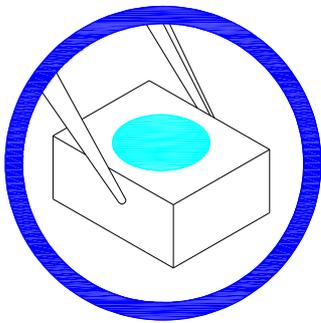
当手工焊接时，烙铁的温度必须小于300°C，时间不可超 3秒

手工焊接只可焊接一次



通

用适当的工具从材料侧面夹取，不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路

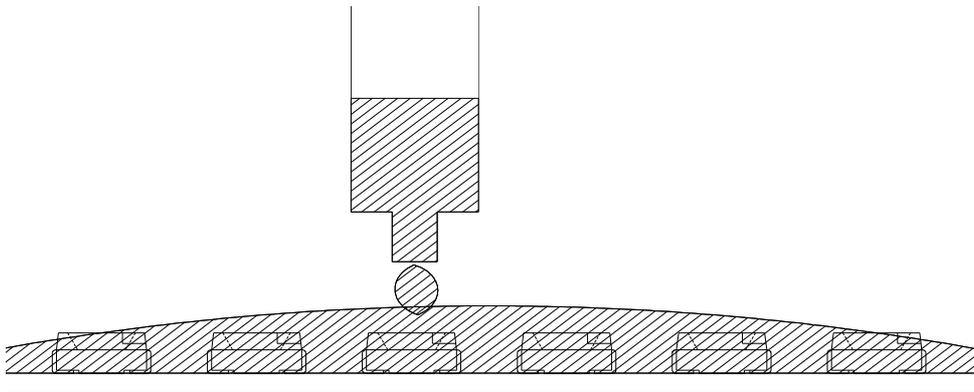


LED工作环境及与LED适配的材料中硫元素及化合物成份不可超 100PPM

LED工作环境及与LED适配的材料中硫元素及化合物成份不可超 100PPM

当我们需要用外封胶涂抹LED产品时，应确保外封胶与LED封胶水相匹配，因为大多数LED的封胶水为硅胶，它有较强的氧化性和较强的吸湿性，必须防止外封材质进入LED内部以成LED的损伤，单一的溴元素含量要求小于900PPM，单一氯元素含量要求小于900PPM，在涂抹LED产品时要求外封胶溴元素与氯元素总含量必须小于1500PPM

当我们需要用外封胶涂抹LED产品时，应确保外封胶与LED封胶水相匹配，因为大多数LED的封胶水为硅胶，它有较强的氧化性和较强的吸湿性，必须防止外封材质进入LED内部以成LED的损伤，单一的溴元素含量要求小于900PPM，单一氯元素含量要求小于900PPM，在涂抹LED产品时要求外封胶溴元素与氯元素总含量必须小于1500PPM



其它注意事项请参照我们的LED 用户手册

